

東証プライム
証券コード：2760



「ジャパニーズ インベスター」誌・宝印刷（株）主催
第100回『個人投資家のための会社説明会』

2024年12月10日
東京エレクトロン デバイス株式会社
代表取締役社長・CEO 徳重 敦之



代表取締役社長・CEO 徳重 敦之

略歴

1986年4月 東京エレクトロン株式会社入社

2005年4月 当社執行役員

2007年6月 当社取締役

2011年6月 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.

(現 TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD.) 董事長

2013年9月 inrevium AMERICA, INC.

(現 TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.) CEO

2015年1月 当社代表取締役社長 (現在に至る)

2024年6月 当社CEO (最高経営責任者) (現在に至る)

当社コーポレートオフィサー (現在に至る)

本日の内容

- 会社概要
- 中期経営計画 VISION2030
- 2025年3月期 通期業績見込み
- 株主還元と株価の推移



会社概要

会社概要



設立年月日	1986年3月3日
業種	卸売業
事業内容	半導体及び電子デバイス事業 半導体、ボード、ソフトウェア、電子部品等の販売、設計・開発 コンピュータシステム関連事業 ネットワーク、ストレージ、ソフトウェアの販売、保守サービス
資本金	24億9千5百万円
売上高	2,428億円（2024年3月期）
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー
従業員数	連結 1,387名（2024年9月30日現在）
上場金融商品取引所	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：2760）
拠点・グループ	国内 15拠点、子会社 7社、関連会社 1社

当社のあゆみ

- 1965年 東京エレクトロン株式会社で電子部品ビジネスを開始
- 1998年 東京エレクトロン株式会社から 電子部品事業
(現：半導体及び電子デバイス事業) を全て譲受け
- 2003年 東京証券取引所 市場第2部上場
- 2006年 東京エレクトロン株式会社から コンピュータネットワーク事業
(現：コンピュータシステム関連事業) を承継
- 2010年 東京証券取引所 市場第1部上場
- 2017年 株式会社アバール長崎 (現：東京エレクトロン デバイス長崎株式会社) を連結子会社化
- 2018年 株式会社ファーストを連結子会社化
- 2022年 東京証券取引所 プライム市場に移行
- 2023年 日本エレクトロセンサデバイス株式会社 からウェーハ検査装置事業譲受け



半導体製造装置メーカー
東京エレクトロン

半導体製造装置事業



専門商社
東京エレクトロデバイス

半導体及び電子デバイス
(EC) 事業

コンピュータシステム関連
(CN) 事業



- EC事業とCN事業が分離・独立
- 東京エレクトロンの出資比率は33.82%
- 東京エレクトロンの持分法適用関連会社

事業内容

最先端の半導体やITシステムなどを提供する **専門商社**
メーカー機能 強化を推進

※セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。

CN 事業

コンピュータシステム関連事業



ITインフラ機器



セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス

EC 事業

半導体及び電子デバイス事業



半導体



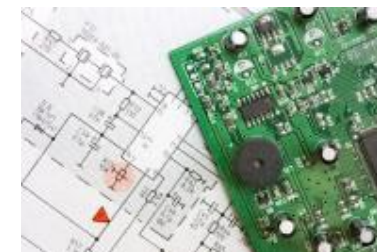
基板（ボード）



クラウドサービス

PB 事業

プライベートブランド事業



設計・量産受託サービス



プライベートブランド製品

商社機能

メーカー機能

事業セグメント

CN 事業

売上高 329億円
セグメント利益 34億円



PB 事業

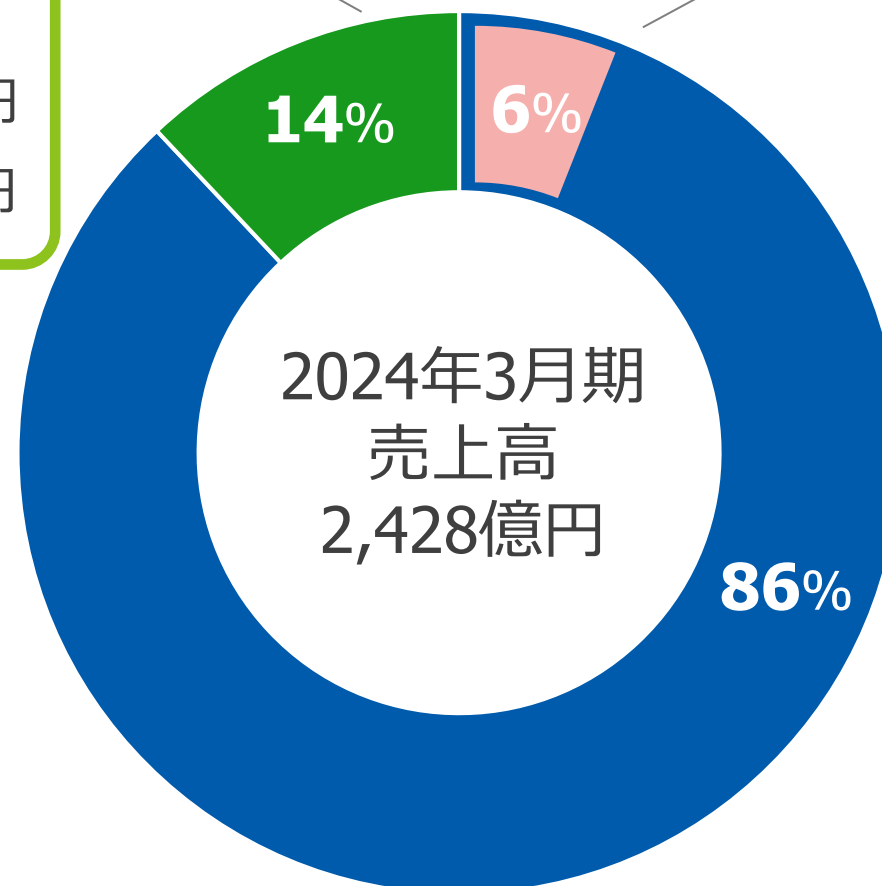
売上高 142億円※

※セグメント区分では、
PB事業はEC事業に含まれております。



EC 事業

売上高 2,099億円
セグメント利益 104億円



東京エレクトロンデバイス

仕入先



海外
ITベンダー



CN 事業

コンピュータシステム関連事業



ITインフラ機器



セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス



販売先

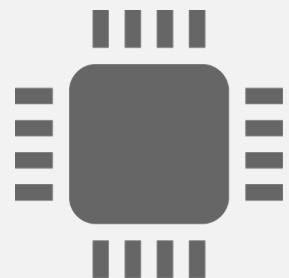


システム会社
データセンター
官公庁
一般企業

ビジネスフロー：EC事業・PB事業

東京エレクトロンデバイス

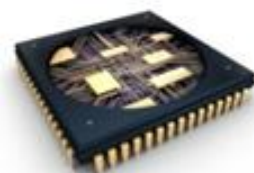
仕入先



海外半導体・
電子部品
メーカー



EC 事業 半導体及び電子デバイス事業



半導体



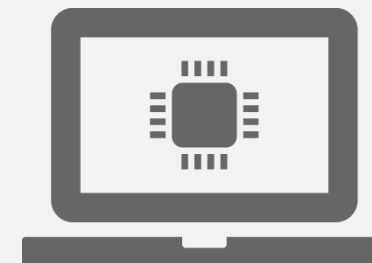
基板（ボード）



クラウドサービス



販売先



電子機器・
産業機器・
車載機器などの
製造業
（メーカー）



PB 事業 プライベートブランド事業



設計・量産受託
サービス

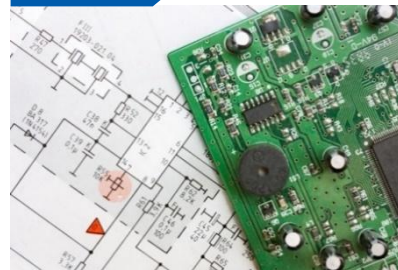


プライベートブランド
製品

エンジニアの技術力を生かした
半導体や基板の開発

設計・量産受託サービス

設計



開発



量産



東京エレクトロンデバイス長崎

製造現場における作業を
自動化する装置

プライベートブランド製品



ウェーハ検査装置



パネル検査装置



ビジョンオートメーションシステム

当社の製品が使用される分野

CN 事業

コンピュータシステム関連事業

EC 事業

半導体及び電子デバイス事業

PB 事業

プライベートブランド事業

分野別売上高構成比



用途別売上高構成比



※グラフ構成比は2024年3月期時点



システムインテグレーター



一般企業



データセンター



通信事業者



産業機器



車載機器



コンピュータ・周辺機器

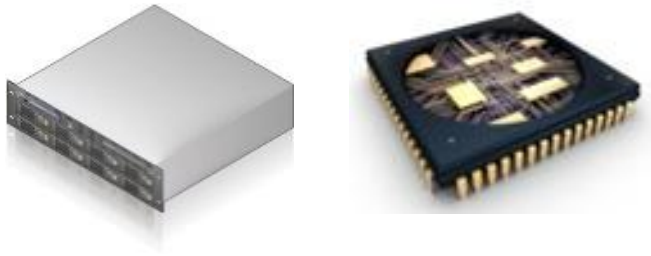


通信機器



民生機器

製品



- 専門性・将来性が高い分野の海外IT製品
- 海外有力メーカーの半導体製品

顧客



- 幅広い分野のお客様
- お客様は大手メーカーを含め 2,000以上

技術



- 製品の技術サポートや保守・監視サービス
- 最先端技術を提供する技術サービス
- 設計・量産受託サービス



中期経営計画 VISION2030

中期経営計画の振り返りと展望

VISION2020

2016年3月期 – 2021年3月期

技術商社
×
メーカー機能

成長エンジンの構築

(2021年3月期実績)

売上高 : 1,432 億円
経常利益率 : 3.2 %
ROE : 11.4 %

VISION2025

2022年3月期 - 2025年3月期

技術商社機能を持つ
メーカーへ

成長ビジネスの立ち上げ

(2024年3月期実績)

売上高 : 2,428 億円
経常利益率 : 5.7 %
ROE : 25.1 %

VISION2030

2026年3月期 – 2030年3月期

メーカーと
技術商社の力で
社会課題を解決

利益成長の加速

(2030年3月期目標)

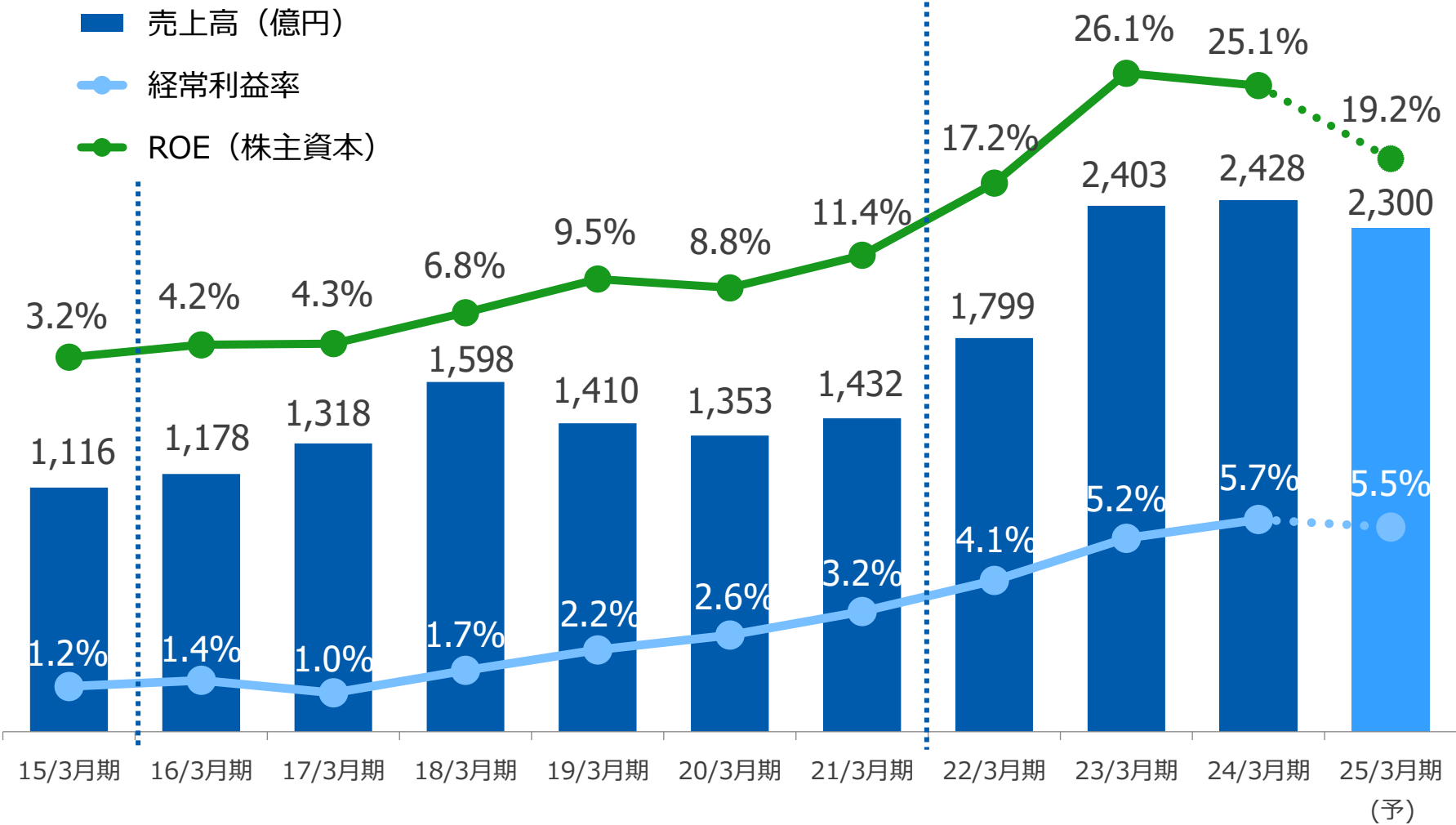
売上高 : 3,000 ～ 3,500 億円
経常利益率 : 8.0 %以上
ROE : 20.0 %以上

中期経営計画 実績と計画



VISION2020

VISION2025



VISION2030 財務指標

売上高	3,000 ~ 3,500億円
経常利益率	≧ 8.0%
ROE (株主資本)	≧ 20.0%

※ 2024年4月30日公表

VISION2025 財務指標

売上高	2,000 億円 ±10%
経常利益率	> 5.0%
ROE (株主資本)	> 15.0%

※ 2020年5月15日公表

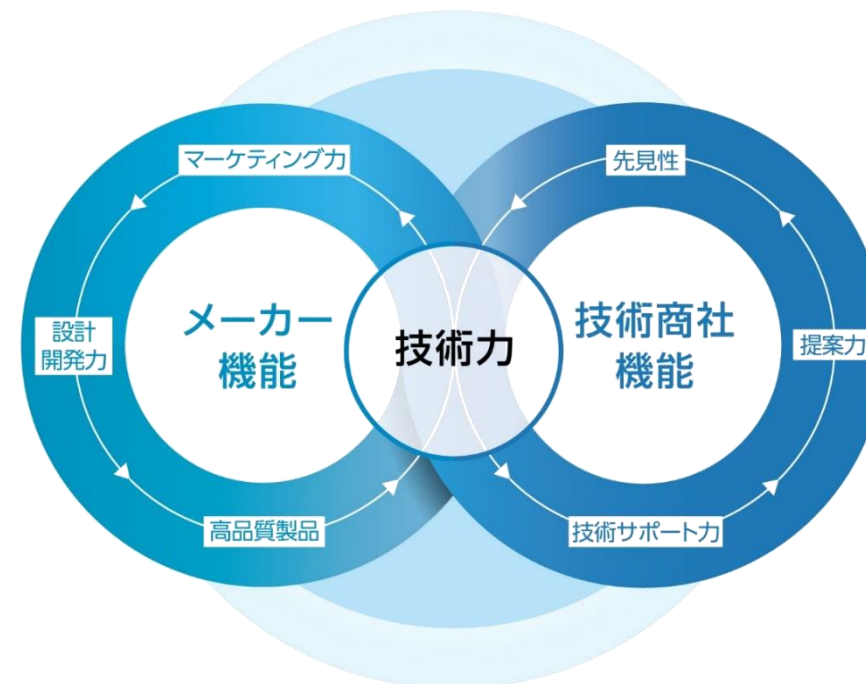
MISSION

半導体やITを中心とする最先端テクノロジーを通して
社会課題に向き合い
期待を超える価値を持つ解決策を提供することで
社会の持続的発展に貢献する



VISION

メーカーと技術商社の力で
潜在的な社会課題を解決する会社



「メーカー」と「技術商社」の力により 潜在的な社会課題（顧客課題）の解決を図る

- 全てのビジネスユニットが、自社製品（サービス）開発にも取り組みグループシナジーを創出することにより、期待を超える価値を持つ課題解決策を提案する
- 潜在的課題に対するマーケティング強化のため、技術商社部門は新規代理店権と顧客商権の獲得を推進する
- 課題解決を可能とする事業基盤の早期確立に向け、積極的にM & Aを活用する

持続的な利益成長に資する行動を推進する

- 差別化できる自社製品（サービス）開発に向けた積極的な投資を行う
- フロー型からストック型サービスビジネスへの移行を推進する
- 中長期利益の拡大に向けた投資（研究開発、人材採用、社員教育等）を行う

CN事業

- 顧客のニーズを理解し、DXを支えるソリューションとサービスを提供
- 顧客のデジタル技術活用を支援し、顧客満足度を向上

EC事業

- 産業機器、車載関連機器、クラウドサービス、OTセキュリティ分野などの成長マーケットに注力
- 半導体の専門知識を生かし、ソリューション型ビジネスを展開

PB事業

- 計測・検査技術を核に、ウェーハ検査装置を中心とした製品をグローバルに提供
- 半導体関連技術と高品質な開発・製造基盤を生かし、医療ODM及び基板OEMのサービスを強化

持続的な利益成長による企業価値のさらなる向上

成長投資

持続的な成長への投資

- 技術開発・事業拡大に向けた積極的な投資（M&A含む）
- 競争力強化を目的とした社内DX、社外DXへの投資
- 人材育成への積極的な投資

株主還元

利益成長による
長期的な高リターン

- 持続的な利益成長を実現し企業価値向上
- 業績に応じた株主還元（配当性向：40%目安）

財務健全性

財務体質の強化と
適切な財務レバレッジ

- 自己資本比率：40%以上
- ROE：20%以上
- 適正な在庫水準の維持

「増益増収」（増益率＞増収率）による 持続的な利益成長を目指す

2030年3月期

- 売上高 3,000 ～ 3,500 億円
- 経常利益率 8 %以上
- ROE（株主資本） 20 %以上

	売上高構成比	目標経常利益率
CN事業	15 %	12 %
EC事業	75 %	7 %
PB事業	10 %	10 %

基本方針

- 事業を通じて提供する様々なソリューションによって、豊かな暮らしと持続的な社会の発展へ貢献します
- マテリアリティ（重要課題）の解決に取り組むことで、当社グループの持続的な発展・企業価値の向上を目指します

マテリアリティ（重要課題）

1. 当社が培ってきたエレクトロニクス及びITを中心としたリソースを活かし、持続的な社会の実現に貢献する。
2. 基本的人権の尊重を根幹に据え、働きやすさ・働きがい意識した労働環境と人事制度を構築し、会社の永続的な発展を目指す。
3. 企業活動により生じる環境負荷（環境リスク）を軽減し、社会と会社が持続可能な関係を継続する。



人的資本／多様性

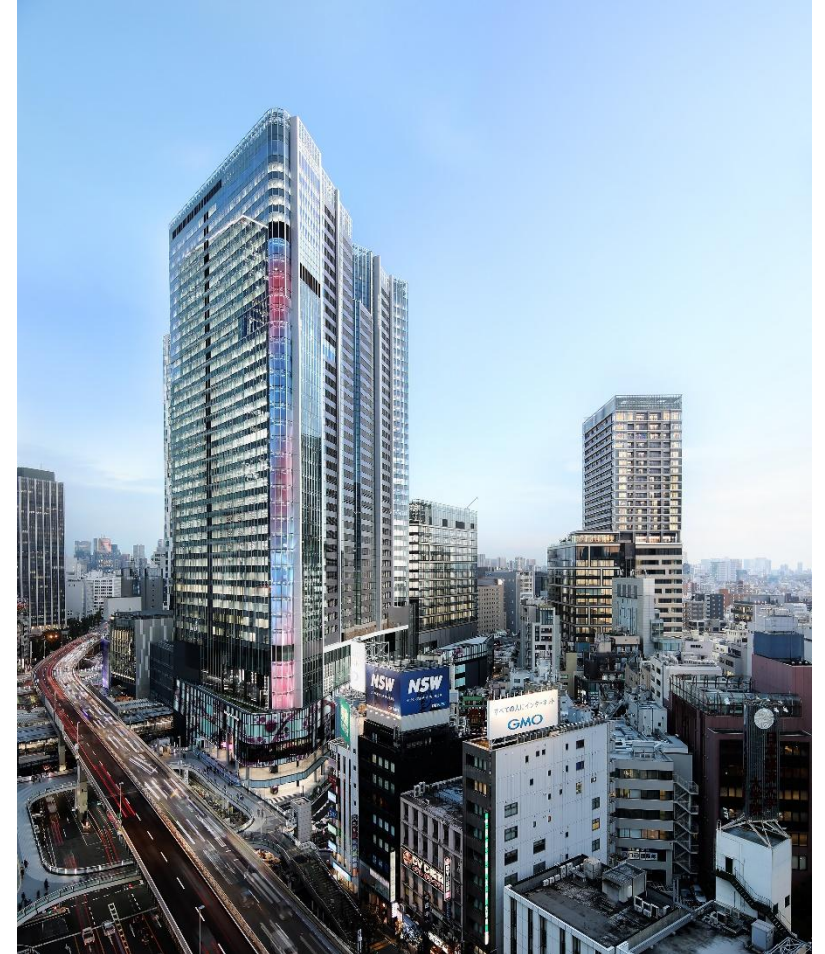
- グローバルな視点で顧客満足を追求める人材の育成
- 社員の向上意欲を支援し、個々の能力を伸ばす環境を整備
- 次世代リーダーの育成に注力

気候変動

- 2050年度 カーボンニュートラルを目指し、2030年度の目標を設定（2021年度対比 50%削減）
- 2023年10月よりエンジニアリングセンター（横浜市都筑区）を実質再生可能エネルギー由来の電力に切り替え

本社移転

- 2024年10月15日 本社を渋谷サクラステージ SHIBUYAタワーに移転
- 新たな価値創造が加速するコミュニケーションセンターへ





2025年3月期 通期業績見込み

通期業績は 売上高・経常利益・当期純利益とも 期初の見込みから変更無し

CN事業は セキュリティを中心に IT市場が堅調に推移

EC・PB事業は 市況の回復基調への転換期が 第4四半期以降へ後ろ倒し

事業計画前提

		2024年3月期	2025年3月期		2026年3月期
		下期	上期	下期	上期
		調整期	底入期		回復期
E C ・ P B	半導体・ウェア市況	サプライチェーンにおける在庫 高水準	徐々に在庫水準適正化へ		
	中国市況	停滞の長期化	徐々に回復基調		
	産業機器	中国市況の影響により低調	徐々に回復基調		
	車載機器	堅調に推移			
	商権	一部メーカー直販の本格化	新規顧客商権の寄与		
C N	市況動向	セキュリティ中心にIT市場は堅調に推移			
	新規代理店契約	新規契約の獲得			
為替動向		前年比 円安で推移	緩やかな円高で推移 (期初想定比)		

2025年3月期 通期業績見込み

(百万円)

	2024年3月期	2025年3月期			対前期比	
	通期	上期実績	下期予想	通期予想	増減額	増減率
売上高	242,888	111,712	118,287	230,000	▲ 12,888	▲ 5.3%
CN事業	32,978	17,687	18,612	36,300	3,321	10.1%
EC事業(連結)	209,909	94,024	99,675	193,700	▲ 16,209	▲ 7.7%
EC事業	195,658	87,038	92,061	179,100	▲ 16,558	▲ 8.5%
PB事業	14,251	6,986	7,613	14,600	348	2.4%
経常利益 (利益率)	13,922 (5.7%)	6,147 (5.5%)	6,552 (5.5%)	12,700 (5.5%)	▲ 1,222	▲ 8.8%
当期純利益 (利益率)	9,986 (4.1%)	4,305 (3.9%)	4,394 (3.7%)	8,700 (3.8%)	▲ 1,286	▲ 12.9%

※ 当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益

変化を先取りした技術・製品への取り組み



海外拠点と連携し最新テクノロジーを常に調査し
最適なソリューションを発掘

ウェーハ検査等の計測・検査技術の開発に注力

- ・Si/化合物ウェーハ(ウェーハ製造)
- ・アドバンストパッケージ工程(デバイス製造)



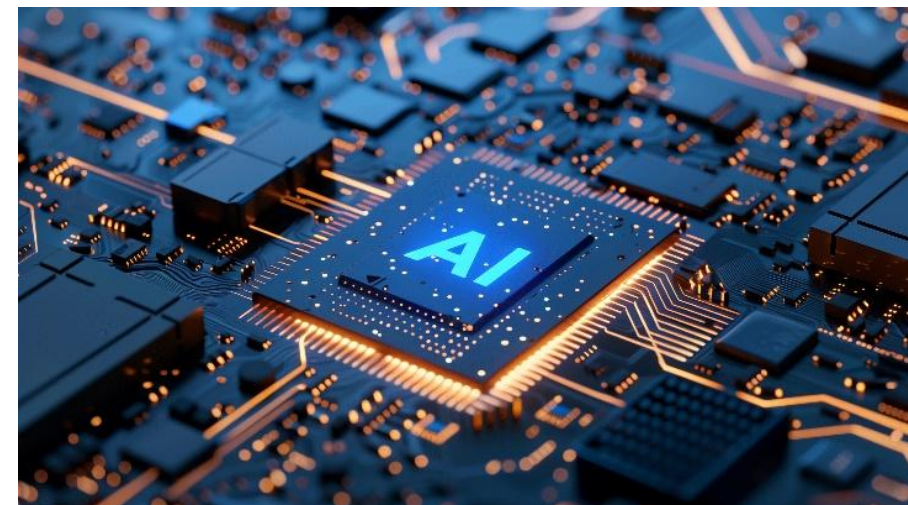
ウェーハ検査装置

検査対象物(ウェーハ材料)の拡大と新たな製造工程課題に対応

クアルコム社と販売代理店契約を締結

高性能・低消費電力の
組込み向けNPU搭載SoC および
SoC搭載モジュール・基板製品の販売を開始

※ NPU：AI専用のプロセッサ



Qualcomm

産業機器分野のエッジAI活用を推進



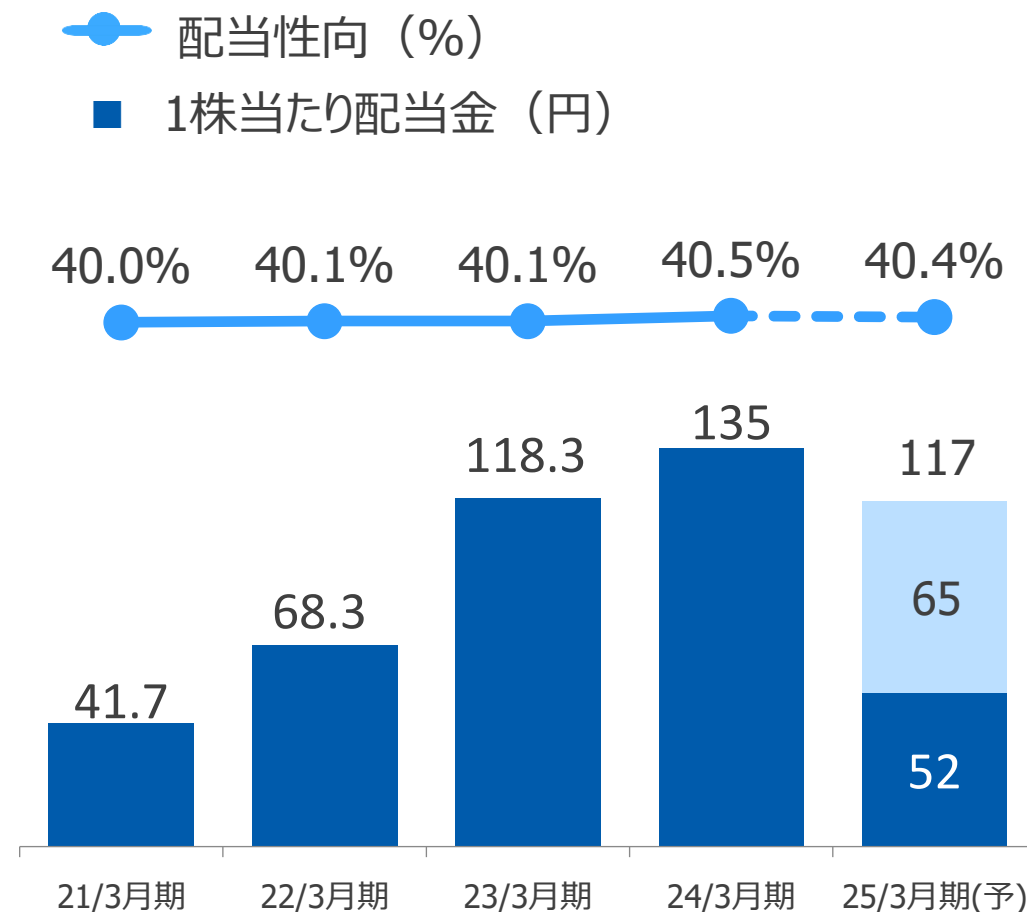
株主還元と株価の推移

1株当たり配当金

(円)

	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期
中間	48.3	61	52
期末	70	74	(予定) 65
合計	118.3	135	(予定) 117

配当金・配当性向



配当政策

- 配当性向 40%
- 安定的・継続的な配当

※ 2023年10月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施（2023年9月以前の配当金額は当該株式分割が行われたと仮定して記載）

株価の推移



2024年12月4日時点	
株価	3,035円
配当利回り	3.9%



ご清聴ありがとうございました

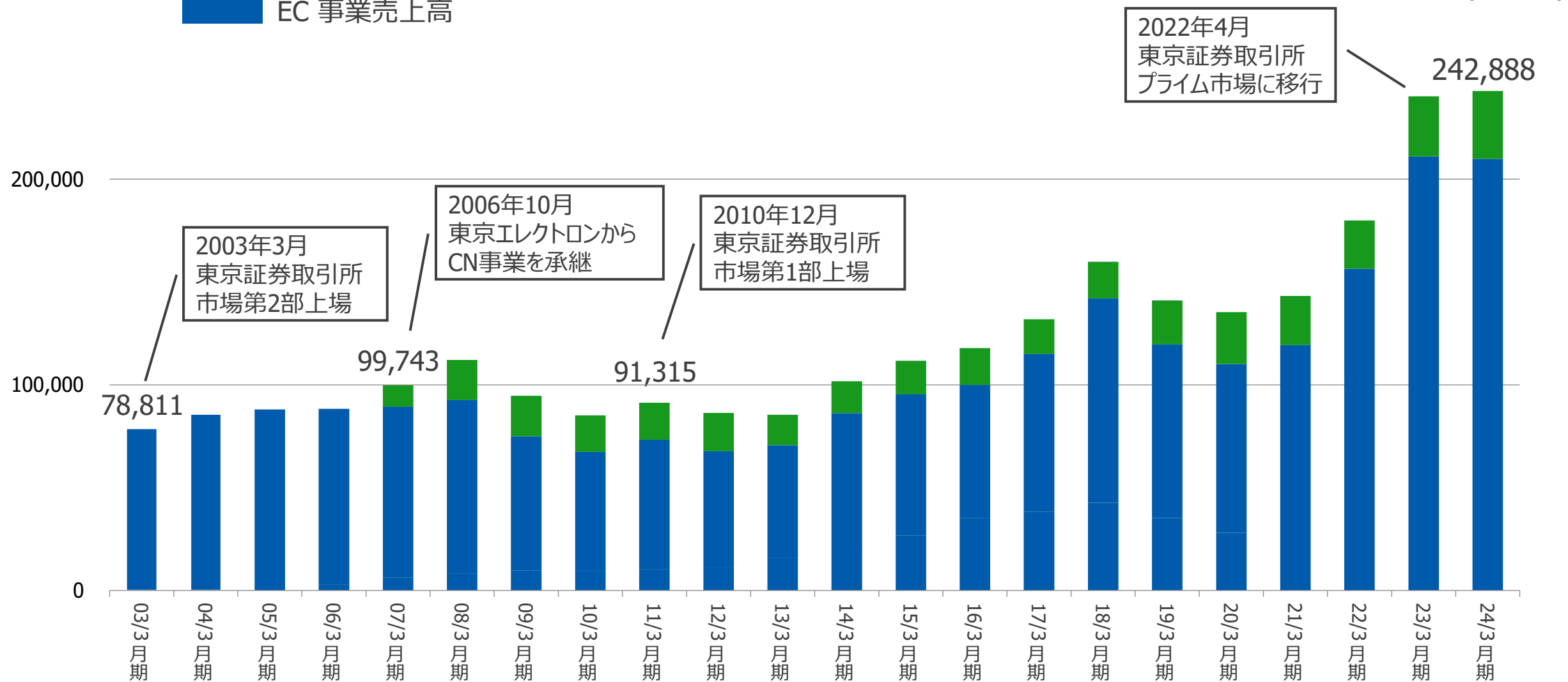
東京エレクトロンデバイス IRサイト
<https://www.teldevice.co.jp/ir>



参考資料：連結業績推移

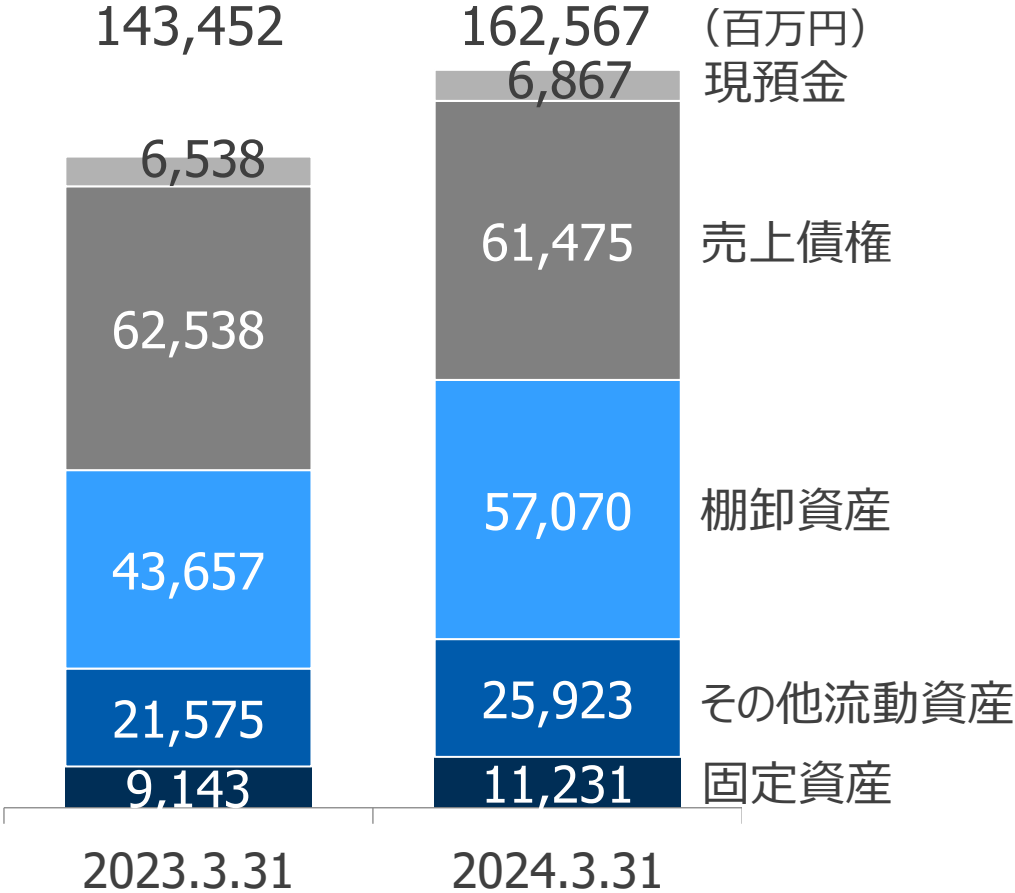
■ CN 事業売上高
■ EC 事業売上高

(百万円)

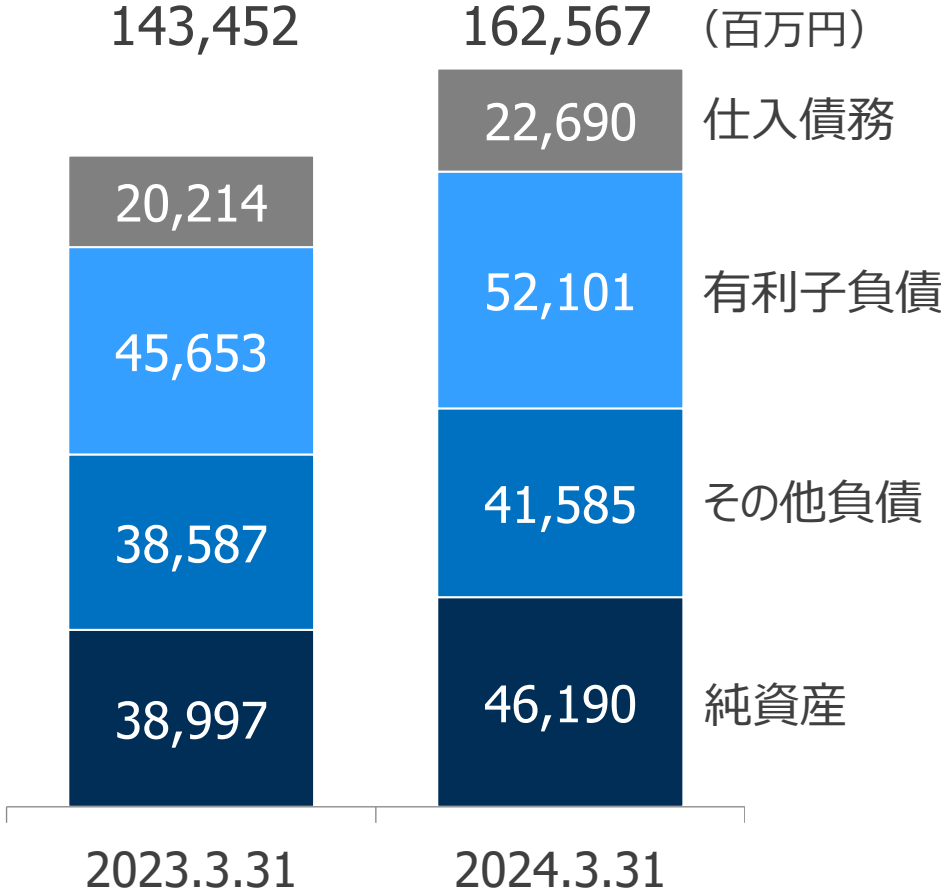


参考資料：貸借対照表

資産

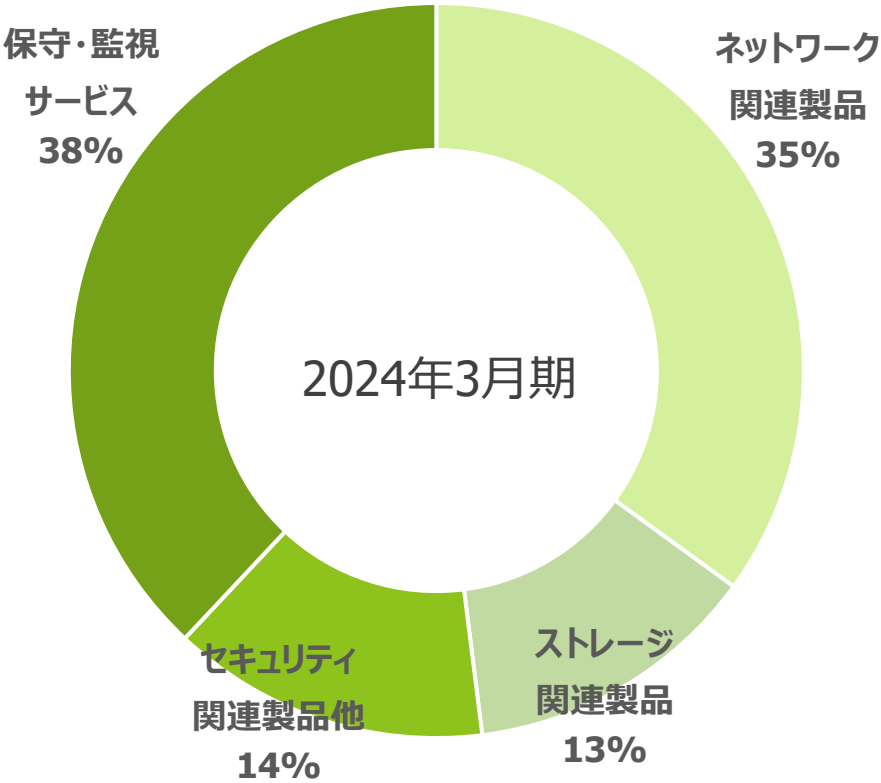


負債・純資産



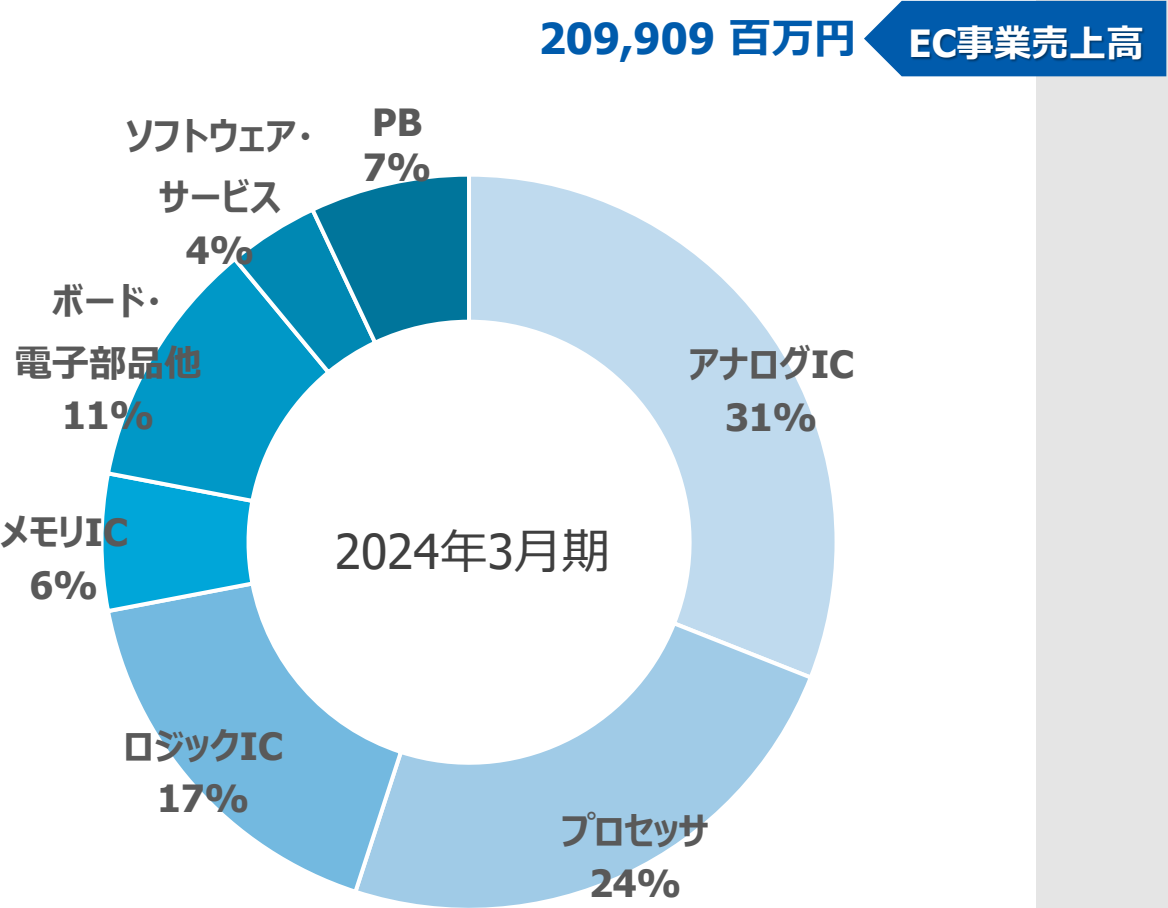
ソリューション	主な製品
ネットワーク 関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ
ストレージ 関連製品	フラッシュストレージ
セキュリティ 関連製品他	エンドポイント ネットワーク クラウド
保守・監視 サービス	機器保守サービス セキュリティ監視サービス

32,978 百万円 CN事業売上高

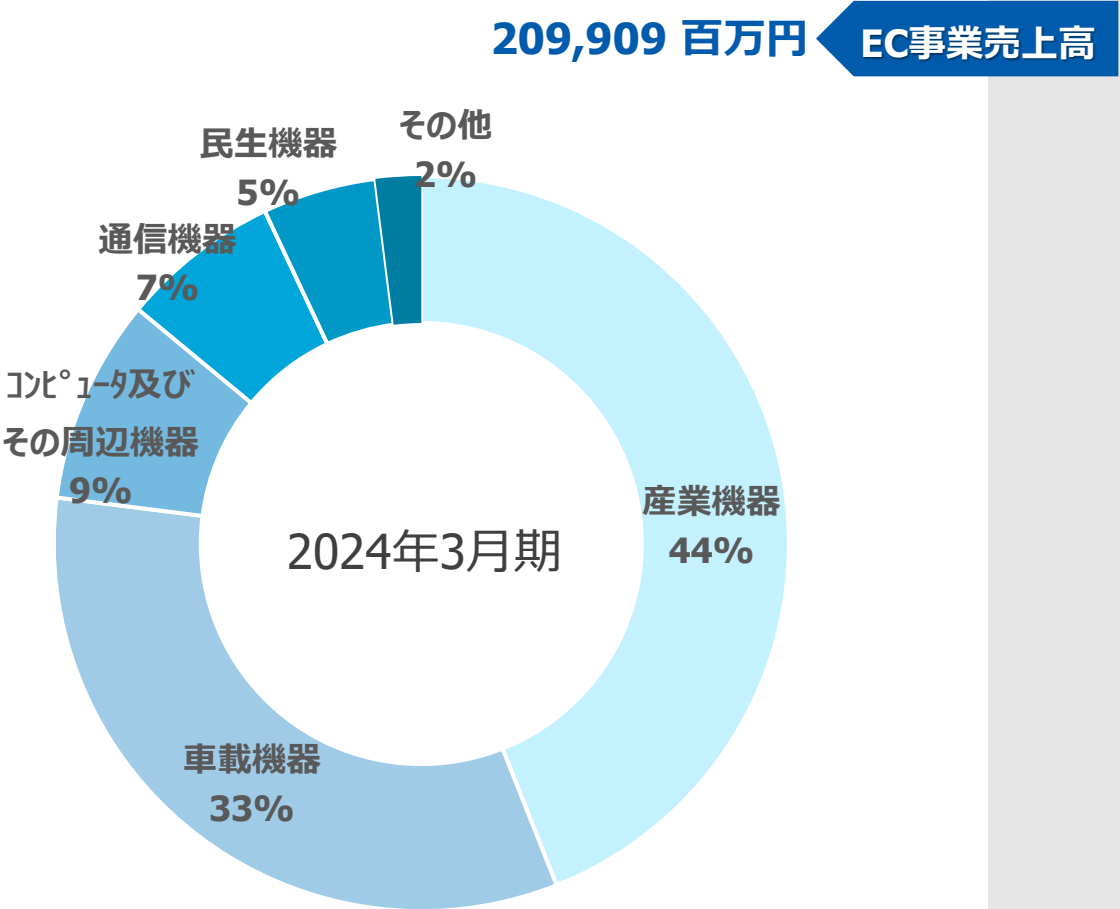


参考資料：EC事業 品目別売上構成比

品 目	主な商品
アナログIC	アナログIC
プロセッサ	CPU DSP
ロジックIC	画像処理用IC 通信・ネットワーク用IC ASIC PLD
メモリIC	SRAM / FRAM / MRAM フラッシュメモリ
ボード・ 電子部品他	ボード / 電源 / 光学部品
ソフトウェア・ サービス	ソフトウェア クラウドサービス
PB	設計・量産受託サービス プライベートブランド製品

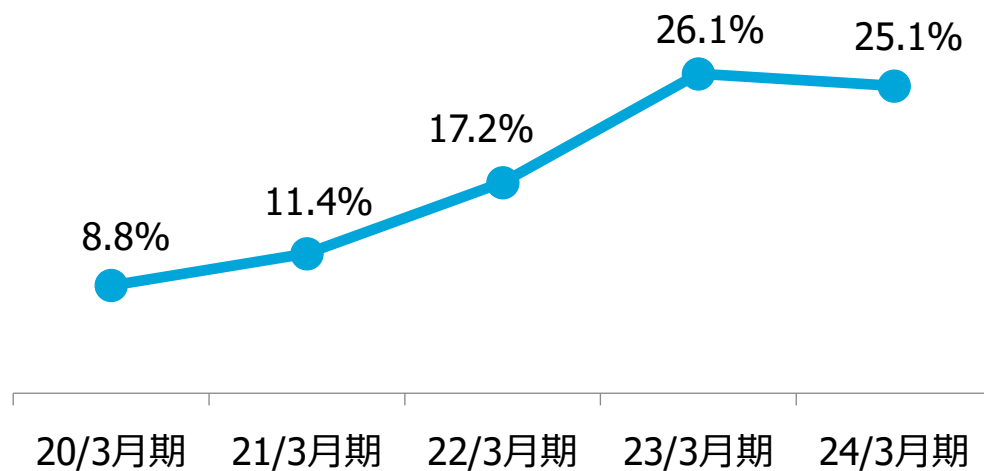


用 途	主な商品
産業機器	医療機器・分析装置 / FA機器 半導体製造装置 / 加工機 / 計測器 工業用ロボット / 制御システム インバータ / 電子部品実装関連装置
車載機器	カーナビゲーション / 車載計器 先進運転支援システム ディスプレイ / 車載用インバータ 車載ECU（電子制御ユニット） リチウムイオンバッテリー
コンピュータ及び その周辺機器	複合プリンタ / POSシステム ストレージ・サーバー プロジェクタ / PC及び付属機器
通信機器	5G基地局 / 光伝送装置 衛星通信機器 ワイヤレスIPネットワーク機器
民生機器	電子楽器 / 家庭用ゲーム機 デジタルカメラ / エアコン / TV・HDDレコーダ / 家庭用燃料電池

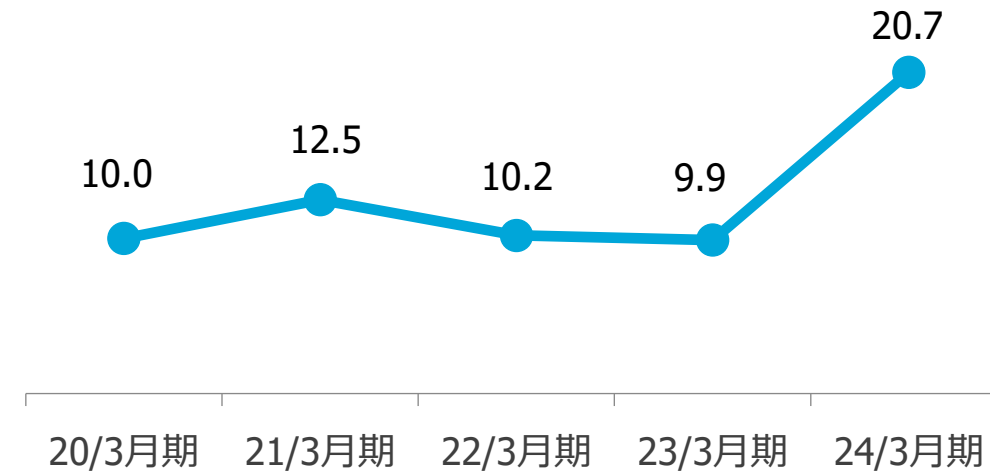


参考資料：経営指標

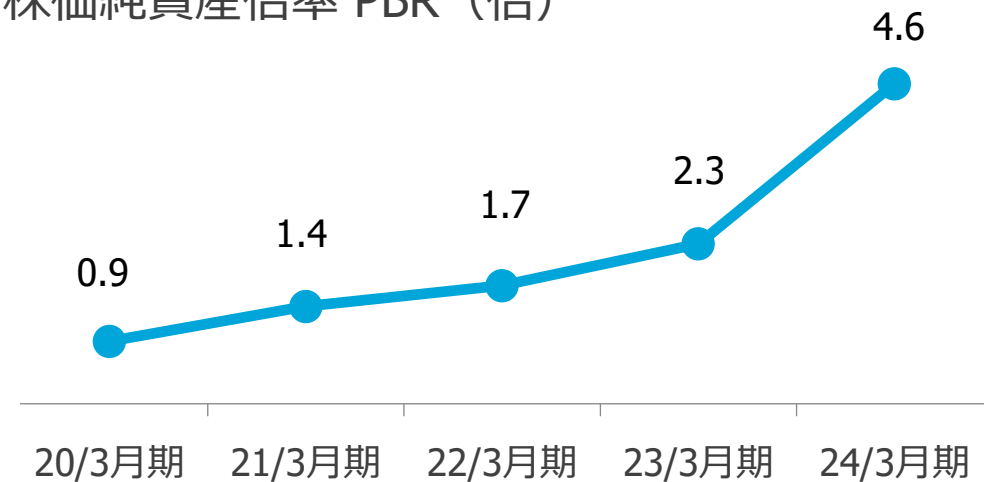
株主資本当期純利益率 ROE (%)



株価収益率 PER (倍)



株価純資産倍率 PBR (倍)



- ※株主資本当期純利益率 (ROE) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本
- ※株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益
- ※株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産



本資料に関する注意事項

本資料で述べられている将来に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な要因により、今後の業績見通しが本資料と異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

本資料に掲載された会社名、製品名、サービス名ならびにロゴは、各社の商標または登録商標です。